

华虹半导体有限公司
(HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED)

与

上海华虹(集团)有限公司

之

减值补偿协议

二〇二五年十二月

减值补偿协议

本《减值补偿协议》(以下简称“本协议”)由以下双方于 2025 年 12 月 31 日于上海市签订:

上市公司: 华虹半导体有限公司(HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED)

注册地址: 香港中环夏慤道 12 号美国银行中心 2212 室

补偿方: 上海华虹(集团)有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区碧波路 177 号

法定代表人: 秦健

本协议上述主体合称“双方”, 单称“一方”。

除非本协议另有定义, 否则本协议项下定义与各方于 2025 年 8 月 29 日签署之《发行股份及支付现金购买资产协议》(以下简称“《资产购买协议》”)项下相应定义具有相同的含义。

鉴于:

1. 双方及其他相关方于 2025 年 8 月 29 日签署《资产购买协议》、于 2025 年 12 月 31 日就《资产购买协议》签署补充协议, 就上市公司拟通过发行股份的方式购买补偿方持有的华力微 63.5443%的股权、购买上海集成电路产业投资基金股份有限公司持有的华力微 15.7215%的股权、购买国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持有的华力微 10.2503%的股权、购买上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)持有的华力微 7.9827%的股权相关事宜进行了约定。
2. 担任本次交易资产评估机构的上海东洲资产评估有限公司已出具编号为东洲评报字【2025】第 2446 号《华虹半导体有限公司拟发行股份购买资产所涉及的上海华力微电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(以下简称“《评估报告》”), 根据该《评估报告》, 截至 2025 年 8 月 31 日, 华力微的全部权益按照市场法评估的评估值为 848,000 万元。

经双方友好协商, 现就本次交易所涉减值测试及减值补偿相关事宜达成本协议如下:

第一条 减值测试资产

- 1.1 根据《评估报告》，本次交易的标的公司华力微系采用市场法确定最终评估价值，因此上市公司在本次交易中拟取得的华力微 97.4988%股权(以下简称“减值测试标的资产”)应进行减值测试。

第二条 减值测试期间及补偿方法

- 2.1 双方一致同意，本次交易的减值测试期间为本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度(以下简称“减值测试期间”)。
- 2.2 在减值测试期间每个会计年度结束后，由上市公司聘请符合《证券法》规定的评估机构对减值测试标的资产进行评估，并出具专项评估报告。根据评估结果，由上市公司对减值测试标的资产的合计价值在每个会计年度进行减值测试，并聘请符合《证券法》规定的会计师事务所出具减值测试专项审核报告(以下简称“减值测试专项审核报告”)。
- 2.3 如减值测试标的资产在减值测试期间任何一个会计年度发生减值(以下简称“期末减值额”)，在符合适用法律法规的前提下，则补偿方应按如下约定向上市公司进行补偿：

期末减值额=本次交易总对价-该会计年度期末标的资产的评估值并扣除减值测试期间内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

补偿方应向上市公司补偿的金额(以下简称“补偿金额”)=补偿方在本次交易中应获得的交易对价占本次交易总对价比例×期末减值额。

补偿方将优先以其在本次交易中获得的上市公司的股份进行补偿，补偿股份由上市公司以 1 元总价回购并予以注销，每年补偿的股份数量为：补偿金额/发行价格-减值测试期间内已补偿股份总数。

在各年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已补偿的股份不冲回。

补偿方在本次交易中获得的上市公司的股份不足以补偿的，补偿方应以现金进行补偿。

2.4 若上市公司在减值测试期间实施送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则上市公司应回购的股份数量应调整为：按上述公式计算的应补偿股份数量 $\times(1+\text{送股或转增比例})$ 。若补偿股份数量出现小数的情况，则应当向上取整作为补偿方应补偿股份的数量。

2.5 补偿方在减值测试期间内就补偿股份已获分配的现金股利应作相应返还，计算公式如下：

返还金额=补偿股份截至补偿前每股已获得的现金股利(以税后金额为准) \times 补偿股份数量。

第三条 减值补偿的执行

3.1 上市公司应在减值测试专项审核报告公开披露后三十(30)个工作日或上市公司确定的其他期限内，依据本协议的计算公式计算并确定补偿方需补偿的金额并予以公告(以下简称“补偿公告”)。补偿方应在补偿公告公开披露之日起三十(30)个工作日内，在符合适用法律法规的前提下，将其用于补偿的上市公司股份由上市公司以总价 1 元的对价回购；或将现金补偿金额足额支付至上市公司指定账户。

3.2 补偿方承诺，其不得通过转让、赠与、设定质押、股票收益权转让或其他权利限制等方式处置其于本次交易过程中取得的、处于锁定期内的上市公司股票。

3.3 补偿方于本协议项下向上市公司补偿的金额总额累计不应超过其在本次交易中取得的总对价。

第四条 法律适用及争议解决

- 4.1 本协议受中华人民共和国法律(仅为本协议之目的, 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区法律)管辖。对本协议条款内容双方存在歧义的, 由双方根据诚实信用、公平合理原则及交易惯例共同解释。
- 4.2 凡因履行本协议所发生的或与本协议相关的一切争议, 双方均应通过友好协商的方法解决。协商不成的, 应最终提交上海仲裁委员会依其当时有效的仲裁规则进行仲裁以解决争议。仲裁应在上海进行且仲裁裁决是终局的并对双方具有约束力。
- 4.3 除提交上海仲裁委员会进行仲裁的争议事项外, 双方应继续履行本协议其它条款。

第五条 违约责任

- 5.1 本协议生效后, 任何一方未能按本协议的约定履行其义务, 即视为该方违约。因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行, 并由此给守约方造成损失的, 违约方应承担赔偿责任。
- 5.2 若违约方的违约行为将导致守约方最终不能取得按照本协议的规定应当取得的利益, 该违约方应当向守约方赔偿守约方预期取得的一切利益。

第六条 协议的生效、变更及终止

- 6.1 本协议自双方签署之日起成立, 自《资产购买协议》及其补充协议全部条款生效之日起生效。
- 6.2 本协议的任何变更、修改或补充, 须经协议双方签署书面协议, 该等书面协议应作为本协议的组成部分, 与本协议具有同等法律效力。双方确认, 对本协议所作的重要或实质性修改还需参照本协议的约定获得所需要的批准、许可、备案后方可生效。
- 6.3 若双方及其他相关方签署的《资产购买协议》解除、终止或被认定为无效, 则本协议同时解除、终止或失效。

第七条 其它

- 7.1 本协议项下双方的权利和义务未经其他方的书面同意不得转让。
- 7.2 本协议与《资产购买协议》及其补充协议不一致之处，以本协议约定为准。
- 7.3 本协议正本壹式伍份，双方各执壹份，其余报政府主管部门审批、核准及办理过户登记手续之用。

(本页以下无正文，下转签署页)

(本页为《减值补偿协议》之签署页)

甲方：华虹半导体有限公司(HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED)(盖章)

授权代表： 任 鸣 (签署) 

(本页为《减值补偿协议》之签署页)

乙方: 上海华虹(集团)有限公司(盖章)

授权代表: _____(签署)

